

DATENBLATT



- **AMD Ryzen 7 9700X**, 8 Kerne, 3.8 bis 5.5 GHz
- **MSI MAG CoreLiquid 360 A13**, ARGB Wasserkühlung (leise)
- Standard Wärmeleitpaste
- **32GB DDR5-6000 MHz** (2x16GB), Dual-Channel
- **NVIDIA GeForce RTX 5070**, 12GB GDDR7
- **ASUS Prime B850-Plus WiFi**, AMD B850, ATX, WLAN+Bluetooth
- **7.1** (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard
- **1000 GB M.2 SSD** (NVMe)
- **ATX-Midi Jonsbo BO400 gunmetal grey**, tempered glass
- **WirelessLAN** (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, LAN 2.5Gigabit (integriert)
- **ADATA XPG Core Reactor II VE**, 850W, 80+ Gold, Modular
- Service24 basic

2.199,00 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Cube Orion AMD**Artikelnummer**
200241**Konfigurationscode**
HWFRU**Lieferzeit**
● 10 - 14 Werktage**Datum**
03.02.2026

ORION Gamer-PC - Designed for Brilliance
Basis: AMD Ryzen 7
Grafik: ab RTX 5070

Tauche ein in die nächste Generation von Performance und Design. ORION vereint futuristische Ästhetik mit kompromissloser Technik - geschaffen für Gamer, Visionäre und Perfektionisten.

Das rahmenstarke, rundum verglaste Gehäuse präsentiert das Innenleben in einem faszinierendem Lichtspiel - ein leuchtender Kern, der Kraft und Eleganz in perfekter Balance zeigt. Jeder Winkel, jede Linie folgt einem Ziel: stark und grenzenlos, wie das Universum selbst.

Der ORION ist nicht einfach ein PC. Es ist ein Symbol für Power, Eleganz und technische Vollkommenheit - gebaut, um zu begeistern.



AMD Ryzen 7 9700X, 8 Kerne, 3.8 bis 5.5 GHz

Prozessor

Typ	Ryzen 7
Codename	Granite Ridge
Modell	Ryzen 7 9700X
Sockel	AM5
Anzahl Kerne	8
Anzahl Threads	16
Taktfrequenz	3.8 GHz
Turbo-Takt	5.5 GHz
unterstützte Speichertypen	bis DDR5-5600
Integrierte Grafik	Radeon
L2-Cache	8 MB
L3-Cache	32 MB
TDP (Thermal Design Power)	65 W
Fertigungsprozess	6 nm

MSI MAG CoreLiquid 360 A13, ARGB Wasserkühlung (leise)

Kühlung

Typ	Wasserkühlung
Bauweise	360mm (triple)
Lautstärke	ab 18 dB(A)
Lautstärke (maximal)	42 dB(A)
Lüfter	3
Lüfterabmessung	120 x 120 x 25mm
Beleuchtung	ARGB
Material	Aluminium
wartungsfrei	ja
Farbe	schwarz

Sockel

115x / 1200	ja
1700	ja
1851	ja
2066	ja
AM4 / AM5	ja
TR4	nein

Gewicht & Abmessungen

Höhe	27.2 cm
Breite	12 cm
Tiefe	2.7 cm

Standard Wärmeleitpaste

Kühlung

Typ	Wärmeleitpaste
Lautstärke	-
Lautstärke (maximal)	-
Lüfter	-

32GB DDR5-6000 MHz (2x16GB), Dual-Channel

RAM

Typ	DDR5
Bauform	DIMM
Kapazität	32 GB
Speichertakt	6000 MHz
CAS Latenzen	CL38
XMP	3.0
Spannung	1.35 V
Hitzeverteiler	Aluminium
Bauhöhe	35mm
Beleuchtung	nein
Farbe	schwarz

NVIDIA GeForce RTX 5070, 12GB GDDR7

Spezifikation

Prozessorhersteller	NVIDIA
Prozessortyp	GeForce RTX
Grafikprozessor	GeForce RTX 5070
Prozessor-Taktfrequenz	2.16 GHz
Maximaler Turbotakt	2.51 GHz
Prozessorkerne	6144
Raytracing-Recheneinheiten	94 TFLOPS
Speichergröße	12 GB
Speichertyp	GDDR7
Speichertakt	21 Gbps
Speicherschnittstelle	192-Bit
HDCP-kompatibel	ja
DirectX Unterstützung	12
OpenGL Unterstützung	4.6
Kühlung	NVIDIA Referenz Kühlung
Lüfter	2
Schnittstelle	PCI-Express 5.0
PCIe-Stromanschluss	1x 16-Pin
Leistungsaufnahme	250 Watt
Empfohlene Netzteilleistung	650 Watt

benötigte Slots	2
VR-Ready	ja

Anschlüsse

VGA	nein
DVI	nein
HDMI	1
Mini-HDMI	nein
DisplayPort	3
Mini-DisplayPort	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein

Auflösung

max. Auflösung (DVI)	-
max. Auflösung (HDMI)	4096 x 2160 @ 60Hz
max. Auflösung (DisplayPort)	7680 x 4320 @ 120Hz
Maximale Displays	4

Gewicht & Abmessungen

Länge	30 cm
Breite	12 cm
Höhe	6 cm

ASUS Prime B850-Plus WiFi, AMD B850, ATX, WLAN+Bluetooth

Spezifikationen

Chipsatz	AMD B850
Sockel	AM5
Format	ATX
Soundtyp	7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Soundchip	Realtek ACL1220P
Netzwerktyp	Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Netzwerkchip	Realtek 2.5Gb Ethernet
WLAN	ja
WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Bluetooth	ja
Bluetooth-Version	5.4
Speicherbänke	2
Speicherbelegung (max.)	96 GB
Speichertyp	DDR5
Speicherformate	4800 MHz bis 8000 MHz (O.C.)
Dual-Channel-Unterstützung	ja
Multi-GPU (Crossfire)	nein
Multi-GPU (SLI)	nein
RAID	0, 1, 10
TPM	optional

Anschlüsse

PS/2	nein
VGA	nein
DVI	nein
HDMI	1
DisplayPort	1
Netzwerk (RJ45)	1
USB 2.0	2
USB 3.0	nein
USB 3.1 (Typ A)	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein
USB 3.2 (5Gbit) Typ A	4
USB 3.2 (10Gbit) Typ A	3
USB 3.2 (20Gbit) Typ C	1
Audio (Klinken)	5
S/PDIF (optisch)	nein

Anschlüsse (intern)

SATA3 (6GB/s)	4
M.2 Sockel (x4 PCIe)	3
USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s)	1 (für 2 USB3.0 Ports)
USB 2.0 (onboard)	4
Steckplätze PCIe 5.0 x16	1
Steckplätze PCIe 4.0 x1	2
CPU Lüfter Anschluss	2x 4-Pin
Zusatz Lüfter Anschluss	4x 4-Pin
24-Pin EATX Strom	1
8-Pin ATX 12V Strom	1
4-Pin ATX 12V Strom	1
Front Audio Anschluss	ja
COM (Seriell) Anschluss	1
S/PDIF Out (onboard)	ja
RGB Connector	2
ARGB Connector	3

7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, Digital Audio, onboard

Anschlüsse und Schnittstellen

Mikrofon	1
Kopfhörerausgang	1
Subwoofer-Out	1

Spezifikationen

Soundchip	onboard
Soundtyp	7.1 Kanal

1000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

Kapazität	1000 GB
Schnittstelle	M.2 (PCIe)
Formfaktor	M.2 2280
Geschwindigkeit (lesen)	bis 2000 MB/s
Geschwindigkeit (schreiben)	bis 1500 MB/s
IOPS 4K (lesen)	bis 74.000
IOPS 4K (schreiben)	bis 85.000
Lebensdauer (MTBF)	ca 1.6 Millionen Stunden

Gewicht & Abmessungen

Länge	80 mm
Breite	22 mm
Gewicht	10 g

ATX-Midi Jonsbo BO400 gunmetal grey, tempered glass

Design

Formfaktor	Midi-Tower
Materialien	Stahl, Glas
Seitenfenster	Temperglas
Beleuchtung	ARGB
Grundfarbe	grau
Dämmung	nein
Fronttür	nein
eingebaute Lüfter	7
Lüftertyp	3x 12cm ARGB (Seite), 3x 12cm (Boden), 1x 12cm (hinten)

Einbaumöglichkeiten

Hauptplatine	ATX, mATX, ITX
max. Grafikkartenlänge	43 cm
max. CPU-Kühler Höhe	18 cm
5.25 Zoll Schacht (extern)	0
5.25 Zoll Schacht (intern)	nein
3.5 Zoll Schacht (extern)	nein
3.5 Zoll Schacht (intern, für HDD)	2
2.5 Zoll Schacht (intern, für SSD)	2
mögliche Lüfter (hinten)	1x 12cm (bereits montiert)
mögliche Lüfter (vorne)	3x 12cm (bereits montiert)
mögliche Lüfter (Seitenteil)	nein
mögliche Lüfter (Deckel)	3x 12cm

Gewicht & Abmessungen

Breite	31 cm
Tiefe	47.5 cm
Höhe	49 cm
Gewicht	12.9 kg

Anschlüsse und Schnittstellen

USB 2.0	0
USB 3.0	2
USB-C	1
Mikrofon	ja
Kopfhörerausgang	ja
Cardreader	nein
Einschaltknopf	ja

WirelessLAN (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3, LAN 2.5Gigabit (integriert)

Spezifikationen

Bluetooth	ja
Bluetooth-Version	5.3
WLAN-Standard	802.11a/b/g/n/ac/ax

ADATA XPG Core Reactor II VE, 850W, 80+ Gold, Modular

Strom

Nennleistung	850W
Effizienz	91%
80 PLUS	80 PLUS GOLD
Format	ATX
Lüfter	120mm
Lautstärke (bei 20% Last)	10.1db(A) - super silent
Lautstärke (bei 50% Last)	12.8db(A) - super Silent
Lautstärke (bei 100% Last)	26.3db(A) - silent
Anzahl 12V Schienen	1
Modular	ja
Effizienz bei 100%	91.4 %

Anschlüsse und Schnittstellen

ATX Stromstecker (24-pol.)	1
ATX 12V (4+4-pol.)	2
EPS 12V (8-pol.)	1
SATA Strom	6
PCIe Strom (6+2-pol.)	3

Energie

Max. Stromstärke (+12V)	70.8A
Max. Stromstärke (+5V)	22A
Max. Stromstärke (+3.3V)	22A

Max. Stromstärke (+5Vsb)	3A
Max. Stromstärke (-12V)	0.3A
Kombinierter Strom (+12V)	850W
Kombinierter Strom (+5V)	120W
Kombinierter Strom (+3.3V)	120W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15W
Kombinierter Strom (-12V)	3.6W

Gewicht & Abmessungen

Breite	15 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	8,6 cm
Gewicht	1,66 kg

Service24 basic

Allgemein

Garantie	24 Monate
Abholservice	6 Monate deutschlandweit
Service & Support	lebenslang
Expressbearbeitung	nein